

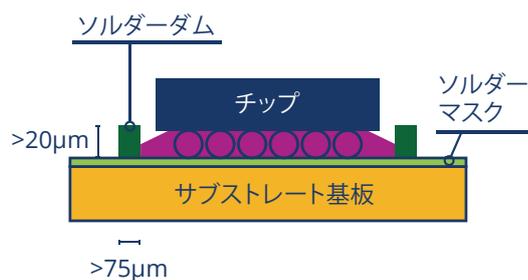
# Orbotech Magna™

## ICパッケージ向けの付加印刷ソリューション

### より機能的に、省スペースに印刷

マイクロエレクトロニクスへの需要が高まるにつれ、封止剤等がダイサイズを超えて漏れ広がることを防ぐため、個別のダイ周辺にバリアとなるダムを低コストかつ正確な位置へ作成できることが求められています。

インクジェット印刷は、従来のコスト高なソルダーマスク工法に代わり、パッケージの省スペース化をサポートします。



### Orbotech Magna - ダム形成

KLAの付加印刷技術により、ダイ周辺に保護バリアを堆積し密閉させることで、お客様はスペースとコストを節約できます。

Orbotech Magnaのインクジェット印刷にて、ダムを形成することで、従来の手法に比べより精度よく、かつコストを抑えることができます。

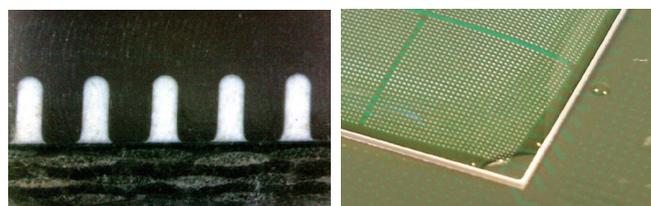
Orbotech Magnaは、貴重なパッケージスペースを節約できるので、FCCSP、BGA、CIPモジュールなどに適しています。

- ダム形成用最先端インクジェット印刷
- ダム高 0.5mm、幅 75µmまでの高アスペクト比をもつ高いダムの積層を可能にする
- 様々なサブストレート表面に対して優れた密着性を提供
- ストリップ、パネル、JEDECトレイ、ウエハーなどに対応
- 高スループット、トータルコスト (TCO) の削減
- 高い積層精度によりダム形成エリア (禁止ゾーン) を削減



### Orbotech Magna - 絶縁層へのダイレクト印刷

- 材料の浪費がない
- 費用のかかるリソグラフ工程を削除 - プロセスの簡略化
- マスクレス
- トータルコストを40%削減
- 新製品 (NPI) の市場投入 (TTM) までの時間短縮
- QFN や CSPへの部分印刷に対応



## 従来のプロセス - 工程が長くコスト高



## Orbotech Magna - 高速、低コストかつ環境に配慮



## 仕様

最大印刷サイズ	304.8 x 406.4 mm
最小/最大ストリップ厚み	0.1 - 6.5 mm
最小/最大解像度	600 - 2400 dpi
最小線幅	75 $\mu$ m
位置精度 (FTG)	$\pm$ 35 $\mu$ m
最大間隔 PH/サブストレート	1.5 mmまで
アライメント方式	ユーザー選択可能; ターゲットマーク数、パーシャルスケーリング
ストリップ / パネルアタッチメント	標準: ストリップハンドリング 真空 + クランプ オプション: カスタマイズキャリア、JEDECトレイ、パネル
ソフトウェア	RIPソフトウェア – CAMとの統合、274Xの入力、ワンタッチ印刷、多言語対応
適用インク	様々なオルボテック推奨インク
寸法 W x D x H*	1000 x 1150 x 2240 mm
重量	900 kg
オートメーション	オートメーション接続可能

\* 高さはタワースライトを含みます

## KLA SUPPORT

高い歩留まりを実現するKLAのソリューションにとって、装置の生産性維持は非常に重要です。この実現のため、当社ではメンテナンス、グローバルでのサプライチェーン管理、コスト削減、製品ライフサイクル管理、装置移設、性能・生産性の向上、認証ツールの再販売などに注力しています。

© 2022 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。「オルボテック」は、KLAカンパニーであるOrbotech Limitedの登録商標です。「KLA」とKLAのロゴは、KLA Corporationの登録商標です。記載されたブランド名および製品名は全て各社の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation  
TEL: 045-522-7725  
Email: Japan-ICS-PCB@kla.com  
www.kla.com

Rev 3.0\_6-13-2022 (J)